

5.5 Rury spustowe – stalowe, ocynkowane 150 mm.

5.6 Styropian – styropian EPS o $\lambda=0,031\text{W}/(\text{mK})$ gr. 15 cm, mocowanie płyt za pomocą zaprawy klejącej oraz kołków plastikowych. Docieplenie gładów okiennych i drzwiowych oraz loggia styropianem 5 cm.

5.7 Tynk elewacyjny, farba elewacyjna – tynk mineralny o fakturze „baranek” (granulacja 1,5 mm). Dwie warstwy farby silikonowej samoczyszczącej, kolorystyka zgodnie z projektem.

5.8 Pasy oddzielenia pożarowego – wełna mineralna REI 120, gr. 15 cm, $\lambda=0,031\text{W}/(\text{mK})$

5.9 Docieplenie poddasza – wełna mineralna wtryskiwana, gr. 24 cm po opadnięciu, $\lambda=0,037\text{W}/(\text{mK})$.

5.10 Drzwi D1 – drzwi aluminiowe częściowo przeszkolone wraz z ościeżnicą, samozamykaczem oraz wkładką. **Uwaga: drzwi w klasie EI60**

5.11 Drzwi D2 – drzwi aluminiowe częściowo przeszkolone wraz z ościeżnicą, samozamykaczem oraz wkładką.

6. Opis rozwiązań wykonawczych.

6.1 Roboty termomodernizacyjne.

6.1.1 Przygotowanie podłoża.

- podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej,
- warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane części muru) należy usunąć,
- nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 do 15 mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą – murarską,
- powłoki słabo związane z podłożem (np. odparzone tynki) należy usunąć i uzupełnić odpowiednią zaprawą tynkarską.
- podłoże chłonne zagruntować preparatem głębokopenetrującym.
- przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach należy wykonać próbę przyczepności.

6.1.2 Montaż płyt styropianowych.

- przed przystąpieniem do montażu styropianu należy zdemontować obróbki blacharskie oraz rury spustowe – zapewniając jednocześnie alternatywne odprowadzenie wód opadowych,
- przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża należy sprawdzić na 4 – 6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatkach technicznych ITB),
- sposób klejenia płyt styropianowych do podłoża (miejsce i ilość nakładania zaprawy klejącej) wg zaleceń producenta systemu,
- płyty styropianowe należy układać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych,